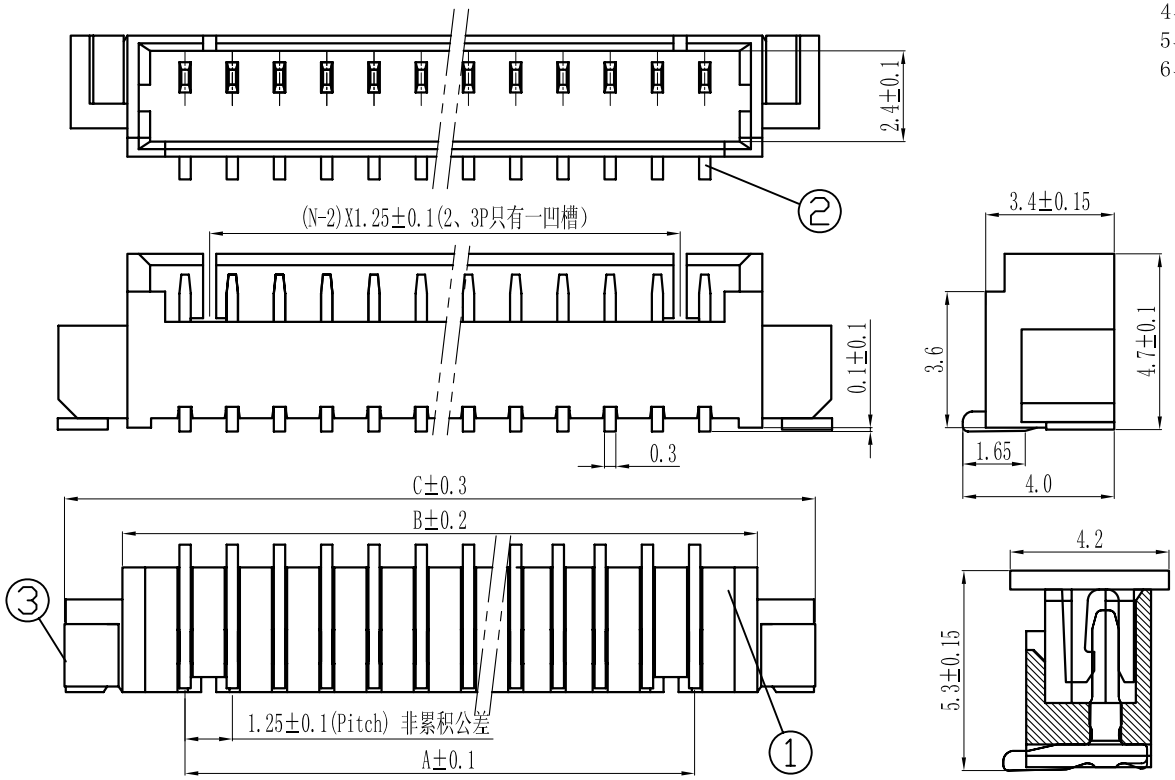
1.25T-立贴承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/1	修 订 版 本	08.09.20
A/2	修 订 版 本	12.09.28
A/3	3.4更改为3.6,0.8变更为1.65	14.12.08

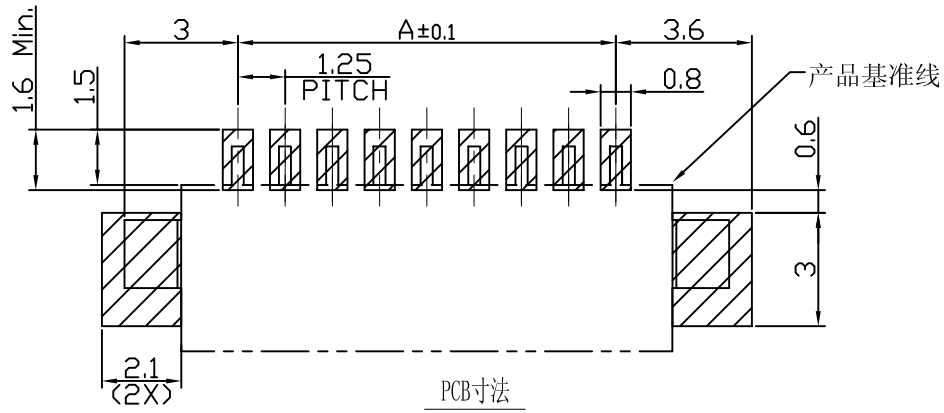
技术指标:
1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
2、温度范围:-25° C~85° C;
3、额定电压:200V,AC,DC(等效);
4、接触电阻:≤0.03Ω;
5、绝缘电阻:≥1000MΩ;
6、耐压:1000V,AC/minute.

ROHS管理规定:
1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。



1.25T-nAB 适合CAP
编带专用

Pin位	Type	A	B	C
2	1.25T-2AB	1.25	4.25	7.3
3	1.25T-3AB	2.5	5.5	8.55
4	1.25T-4AB	3.75	6.75	9.8
5	1.25T-5AB	5	8	11.05
6	1.25T-6AB	6.25	9.25	12.3
7	1.25T-7AB	7.5	10.5	13.55
8	1.25T-8AB	8.75	11.75	14.8
9	1.25T-9AB	10	13	16.05
10	1.25T-10AB	11.25	14.25	17.3
11	1.25T-11AB	12.5	15.5	18.55
12	1.25T-12AB	13.75	16.75	19.8
13	1.25T-13AB	15	18	21.05
14	1.25T-14AB	16.25	19.25	22.3
15	1.25T-15AB	17.5	20.5	23.55
16	1.25T-16AB	18.75	21.75	24.8



PCB寸法
PCB Layout

序号	图 号	名 称	材 料	数 量	附 注
3	122-1018-001	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(镍):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀镍80u".MIN.
2	112-1018-001	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n×1	电镀(镍):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀镍80u".MIN.
1	132-1018-001	基座 Wafer	PA9T(UL94V-0)	1	本色

未 注 公 差			KAPON 深圳市卡邦科技有限公司					
X.° ±3° X.X° ±0.5°								
<10	10—30	>30	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
±0.2	±0.25	±0.3	MM Only	---	METRIC	A4	1 OF 1	
制 作	审 核	批 准	材 料	图 号	006-1018-001		Part No	61018-**01-1001
崔华文	洪新江	H.DR	见图解	品 名	1.25T-nAB			

旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

Q/XFE.R&D-307-61018-022